

## 半導体 Fab の自動化を実現する Automated Material Handling System

村田機械株式会社 クリーンFA事業部 SE部 本告陽一

300 mm半導体 Fab の自動搬送は2000年から本格化され、その需要と規模は年々急速に拡大しています。その様な状況の中、弊社では幅広いユーザとのやり取りを通して、マーケットの見通しやニーズを学び、独創的な発想と製品開発で需要に応じた提案を行い、搬送トレンドを牽引して来ました。

メガFab、ギガFabと巨大化を続ける半導体Fabにおける搬送Through-putは年々増加しており、またプロダクト Mixなどで複雑化しています。その為、搬送システムは半導体Fabの大動脈とも呼ばれるほど重要な役割を担うようになって来ました。

安全性、信頼性はもとより、大容量搬送、短リードタイムの搬送を実現するためには、最適な搬送システム設計と柔軟なシステム運用が重要となります。

今回の講演では、最新 Fab 内の自動搬送システムのご紹介に加えて、これまでの搬送トレンドの変遷を振り返り、今後の課題及びトレンドの見通しについても考えて行きたいと思えます。

